

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2026-024

锦州神工半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股10,305,736.00股，每股发行价格为人民币29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除各项发行费用合计人民币3,943,396.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]110Z0012号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023年9月，公司、国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券

股份有限公司)与招商银行锦州分行营业部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至2026年3月31日止,公司前次募集资金余额(含银行理财)为0.00元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

银行名称	银行帐号	账户类别	初始存放金额(元)	余额(元)
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	活期	210,000,000.00	已注销,零余额
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	活期	86,999,974.96	已注销,零余额
合计			296,999,974.96	

注1:初始存放金额与实际募集资金净额差异943,396.22元,系从募集资金专户中用于支付审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

注2:募投项目之“补充流动资金”对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理,公司于2024年12月将募集资金结余利息收入0.14万元补充到公司银行存款账户,同时注销公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行开立的募集资金专户(账户号:0708004329200669624)。

注3:根据公司2026年1月23日第三届董事会第十一次会议、2026年2月10日2026年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。为方便账户管理,公司于2026年3月将节余募集资金13,223.57万元补充到公司银行存款账户,同时注销公司在招商银行锦州分行营业部开立的募集资金专户(账户号:416900037710703)。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2026年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况：

根据公司2026年1月23日第三届董事会第十一次会议、2026年2月10日2026年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金13,223.57万元永久补充流动资金。

2023年公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”时公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。但随着半导体行业需求变化，外部环境较决策时已发生明显变化。全球和中国的市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化：一方面，由于全球半导体市场的结构性行情，导致市场整体景气度恢复的时间晚于公司最初预测，该业务的产能利用率未达预期；另一方面，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，改变了既有的全球产业格局，公司大直径硅材料的直接下游产品硅零部件受到国产化需求带动，实现连续大幅增长，成为公司第二增长曲线，对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求，需要资金投入。公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素，审慎决定不再继续投入原募投项目。“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”终止有利于合理利用募集资金，提高资金使用效率，不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司承诺募集资金投资金额、实际投资金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	20,905.66	8,257.64	-12,648.02
2	补充流动资金	9,000.00	8,700.00	21,971.68	13,271.68

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
	合计	30,000.00	29,605.66	30,229.32	623.66

集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目募集后资金承诺投资金额 20,905.66 万元，截至 2026 年 3 月 31 日实际投资总额 8,257.64 万元，差异原因为公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素，审慎决定不再继续投入该募投项目，并将节余募集资金 13,223.57 万元永久性补充公司流动资金。

补充流动资金项目募集后资金承诺投资金额 8,700.00 万元，截至 2026 年 3 月 31 日实际投资总额 21,971.68 万元，差异原因为集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目节余募集资金 13,223.57 万元补充公司流动资金及购买理财产品产生的收益及利息收入投入项目所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,337,697.02 元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]110Z0157 号）。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 11,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况。

（六） 前次募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 10 月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金 13,223.57 万元永久补充流动资金。

截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次向特定投资者发行股票募集资金已全部使用完毕，且专用账户已全部注销完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位: 锦州神工半导体股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 29,605.66						已累计使用募集资金总额: 30,229.32				
变更用途的募集资金总额: 13,223.57						各年度使用募集资金总额:				
						2023 年: 2,582.84				
变更用途的募集资金总额比例: 44.67%						2024 年: 9,765.69				
						2025 年: 4,556.15				
						2026 年 1-3 月: 13,324.64				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	20,905.66	8,257.64	21,000.00	20,905.66	8,257.64	-12,648.02	注
2	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	8,700.00	21,971.68 (注)	9,000.00	8,700.00	21,971.68	13,271.68	不适用
合计			30,000.00	29,605.66	30,229.32	30,000.00	29,605.66	30,229.32	623.66	

注: 根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议, 审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止, 公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户。截至 2026 年 3 月 31 日, 募投项目已终止且募集资金已使用完毕并销户。